

株式会社東京精密 2019年度(2020年3月期) 第2四半期 決算説明会

2019年11月8日

*

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- ▶ 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ▶ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ▶ 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- ▶ 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- ▶ 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ **監査について**

- ▶ 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 第2四半期 業績説明
- ◆ 中期目標
- ◆ 2019年度 業績予想
- ◆ 質疑応答

2019年度第2四半期 連結業績



半期業績(億円)	2018年度		2019年度			
	上期	下期	上期	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	572	417	383		-8%	-33%
売上高	512	503	420	-10	-17%	-18%
営業利益 (営業利益率)	102 (20%)	100 (20%)	56 (13%)	-3	-44%	-45%
経常利益	108	100	57	-2	-43%	-46%
当期純利益	79	68	43	+1	-37%	-46%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	282	290	240	177	187	196	+5%	-32%
売上高	198	314	237	266	180	240	+34%	-23%
営業利益 (営業利益率)	31 (16%)	71 (23%)	48 (20%)	52 (20%)	18 (10%)	38 (16%)	+110%	-47%
経常利益	34	74	48	52	19	38	+102%	-48%
当期純利益	26	53	35	33	14	29	+104%	-46%

半導体製造装置・計測機器セグメントともに売上減少等により減収減益

Nov 8th ,2019

Copyright 2019

Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

4

○ 2019年度上期業績は、

受注高383億円, 売上高420億円, 営業利益56億円

経常利益57億円, 親会社株主に帰属する当期純利益は43億円

公表予想に対しては、ほぼ想定線の着地

前年同期比では、売上減少を主因に、利益も減少

○第2四半期業績(以下2Q)は、出荷増に伴い、第1四半期(以下1Q)比で増収増益

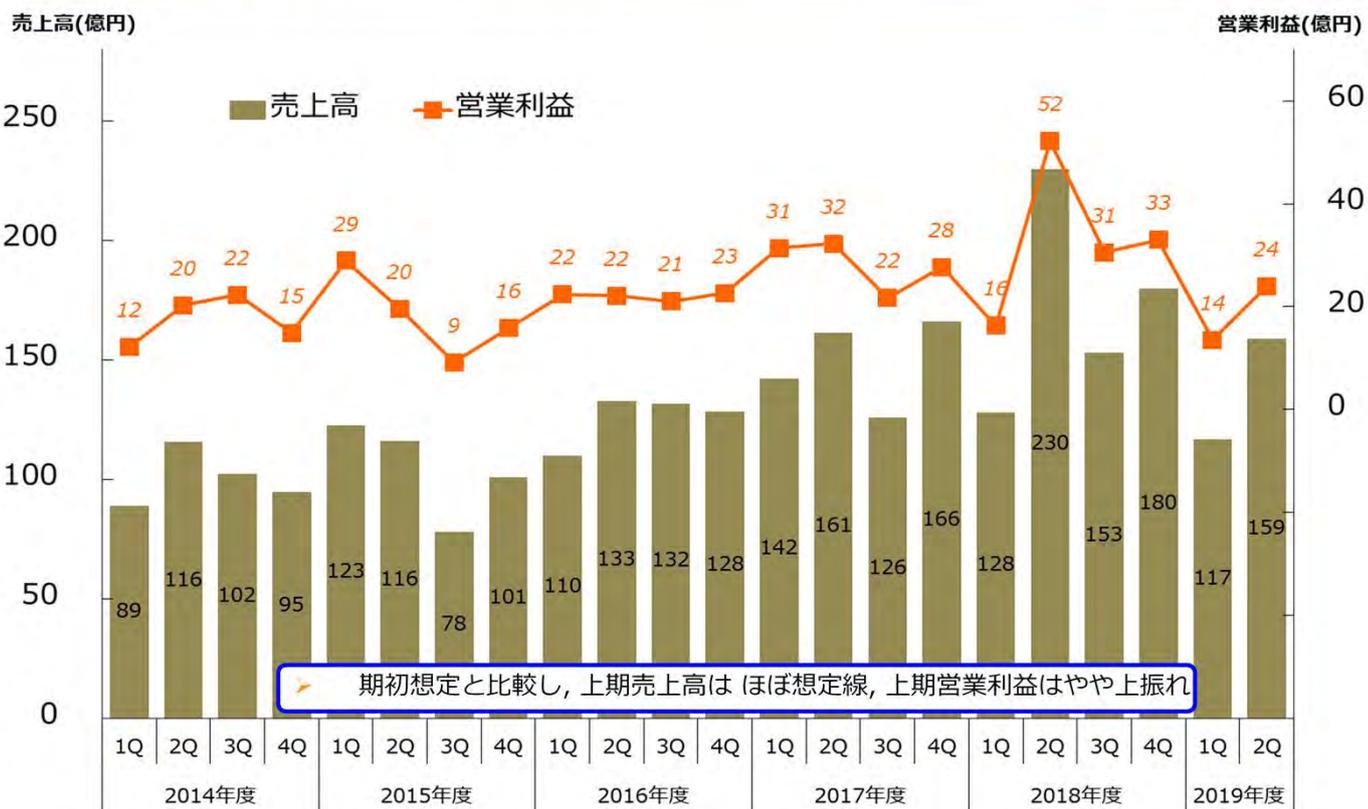
セグメント業績 (半期：億円)	2018年度		2019年度			
	上期	下期	上期	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	397	256	229		-11%	-42%
売上高	358	333	276	+1	-17%	-23%
営業利益 (営業利益率)	68 (19%)	64 (19%)	38 (14%)		-41%	-44%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前半期比	前年同期比
受注高	193	204	151	105	107	122	+14%	-40%
売上高	128	230	153	180	117	159	+36%	-31%
営業利益 (営業利益率)	16 (13%)	52 (23%)	31 (20%)	33 (18%)	14 (12%)	24 (15%)	+77%	-54%

- 2Qに一部 納入に時間を要している受注済案件の取消処理を実施
結果, 受注高・受注残高が約20億減少

- 半導体製造装置セグメント(以下, 半導体) 上期業績
受注高229 億円, 売上高276億円, 営業利益38億円,
第2四半期は同122億円, 159億円, 24億円
- 2Qに, すでに受注され, 納入に時間を要している案件を中心に取消処理を実行
この結果, 2Q受注高, 受注残高が実勢に対し約20億円減少

半導体 - 売上高, 営業利益



Nov 8th ,2019

Copyright 2019

Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

6

- 2Qの売上・利益は1Q比で増加
- 想定対比では, 上期売上高はほぼ想定線, 上期営業利益はやや上振れ

半導体 - 受注高, 受注残高



- 2Q受注高に, 実勢ベース(受注取消処理反映前)を併記
実勢ベース受注高は, 1Q比 3割程度増加, 回復基調にある
- 期初想定と比較し、上期受注高はほぼ想定線

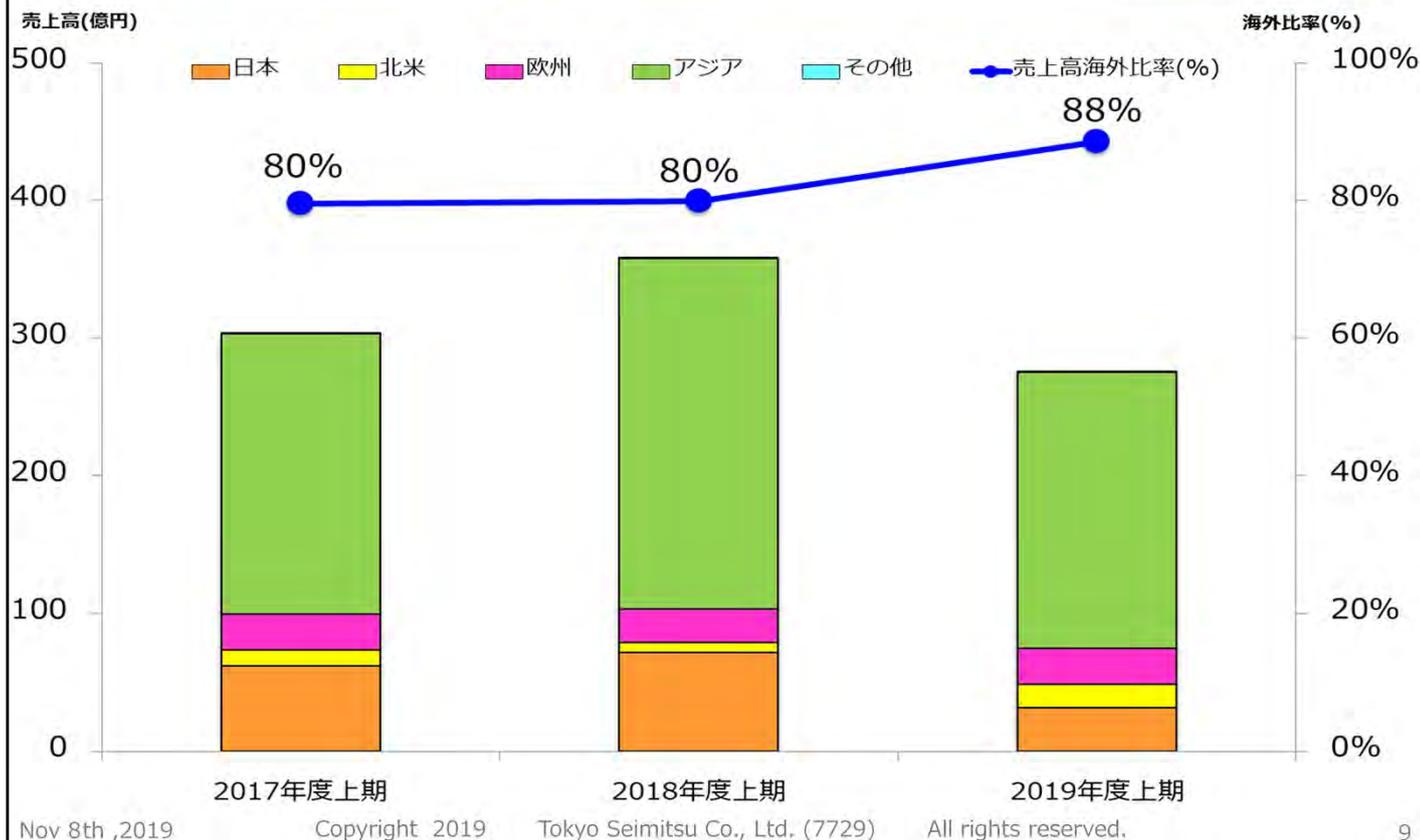


○ 2019年度上期製品別受注高(右側)は実績に加え、実勢ベースを併記

○ 総じて、検査装置(プローバ)の水準は、2017年度上期並みの水準

○ 製品別比率：売上高, 受注高共に
 検査装置(プローバ) 6割後半, 加工装置(ダイサ・研削装置) 3割前半
 (実勢ベースでは、検査装置7割, 加工装置3割)

半導体 - 地域別売上高



○ 2019年度上期 海外売上高比率は88%

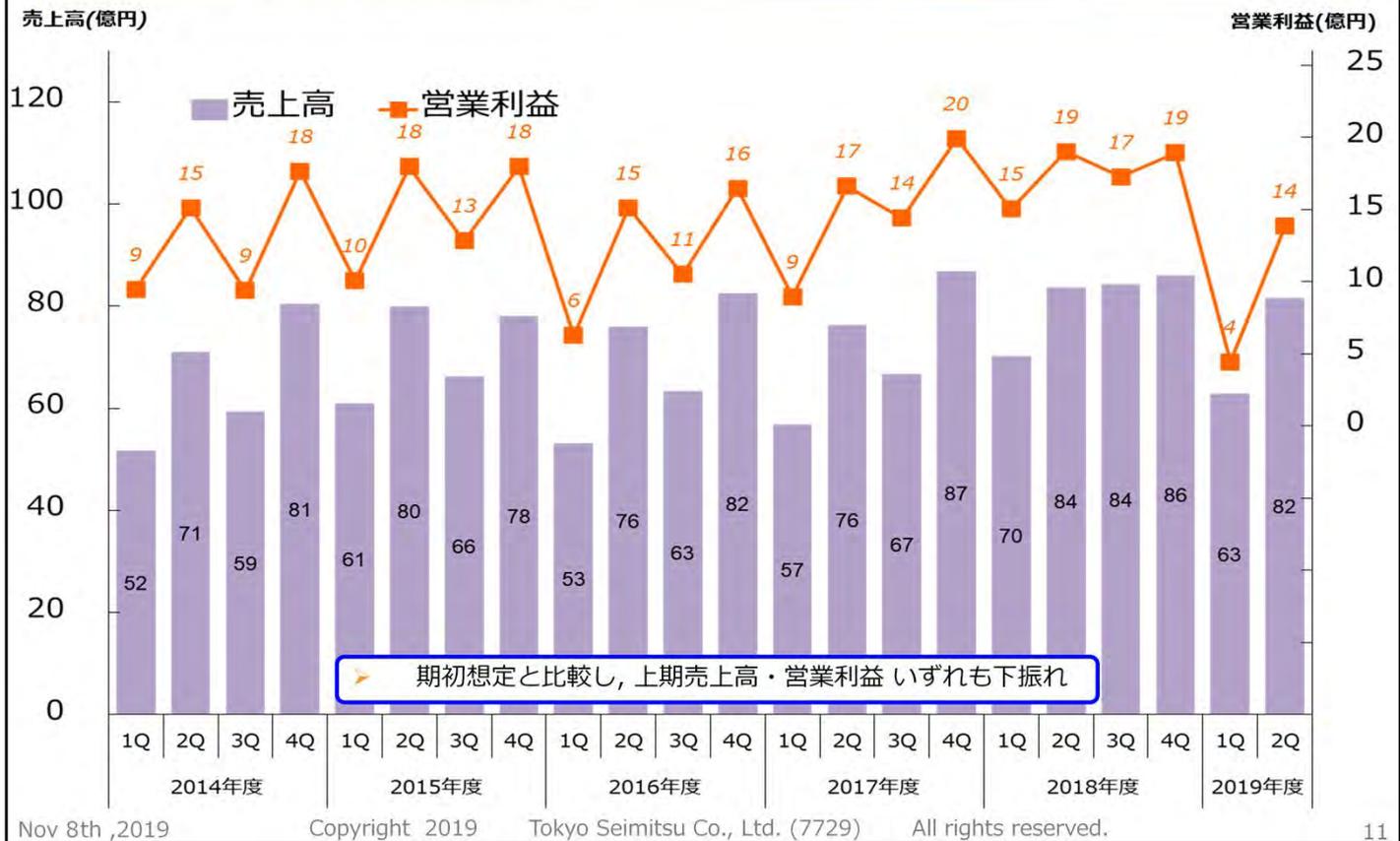
セグメント業績 (半期：億円)	2018年度		2019年度			
	上期	下期	上期	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	175	161	154		-4%	-12%
売上高	154	170	144	-11	-15%	-6%
営業利益 (営業利益率)	34 (22%)	36 (21%)	18 (13%)		-49%	-46%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前半期比	前年同期比
受注高	89	86	89	72	80	74	-7%	-14%
売上高	70	84	84	86	63	82	+30%	-2%
営業利益 (営業利益率)	15 (21%)	19 (23%)	17 (21%)	19 (22%)	4 (7%)	14 (17%)	+213%	-27%

- 自動車関連顧客を中心に設備投資は慎重
- 1Qの一過性費用(子会社退職給付費用:約2億)に加え, 充放電試験システム事業の開発/改革費用が営業利益を押し下げ

- 計測機器セグメント(以下, 計測) 上期業績は,
受注高154 億円, 売上高144億円, 営業利益18億円,
第2四半期は同74億円, 82億円, 14億円
- 自動車関連を中心に設備投資は慎重となり, 受注高・売上高に影響
- 営業利益は, 売上減少に加え, 一過性費用などが含まれる

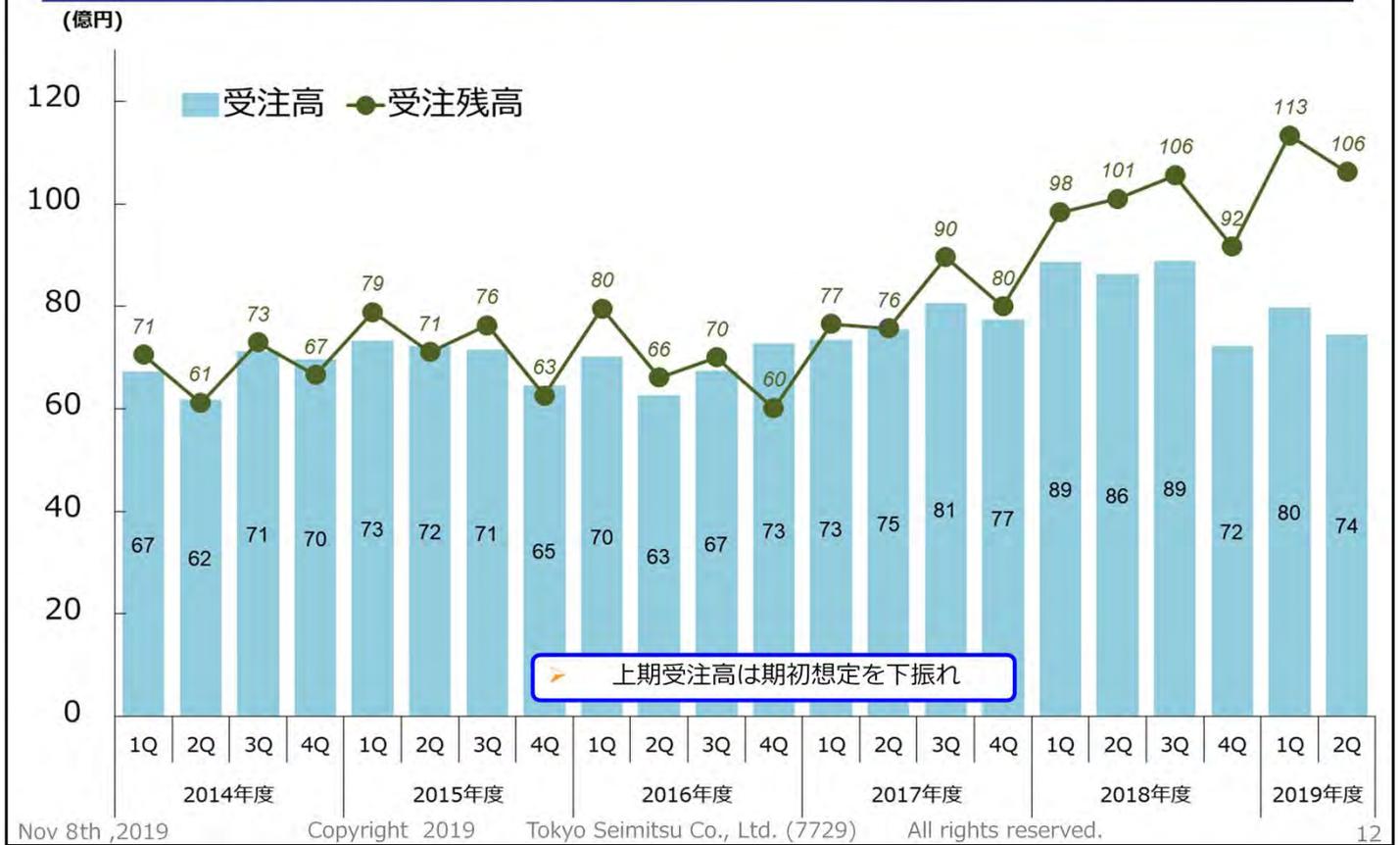
計測 - 売上高, 営業利益



○ 2Qは出荷が進み, 1Q対比増収増益

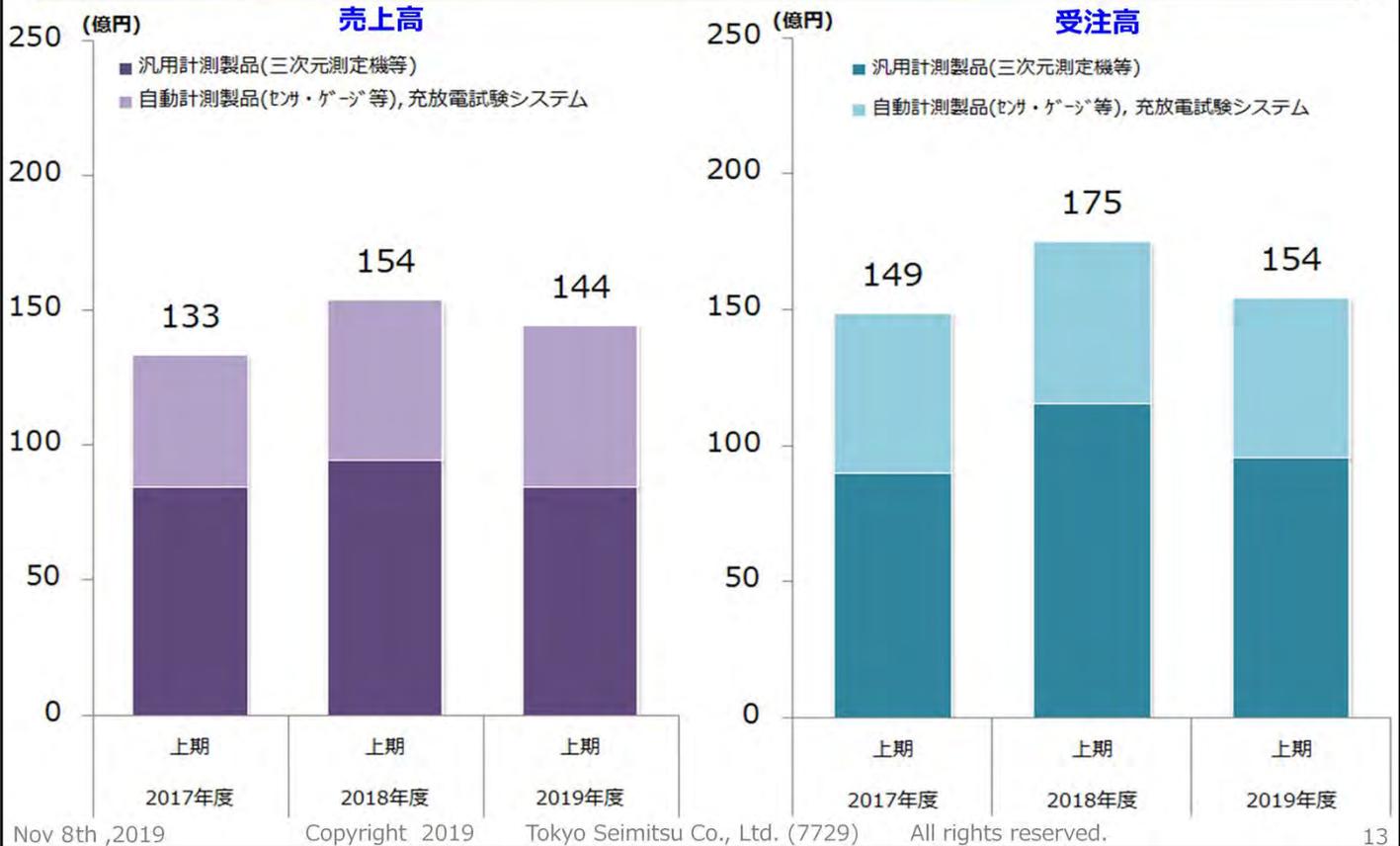
○ 期初想定との比較では、上期売上高・営業利益 いずれも下振れ

計測 - 受注高, 受注残高



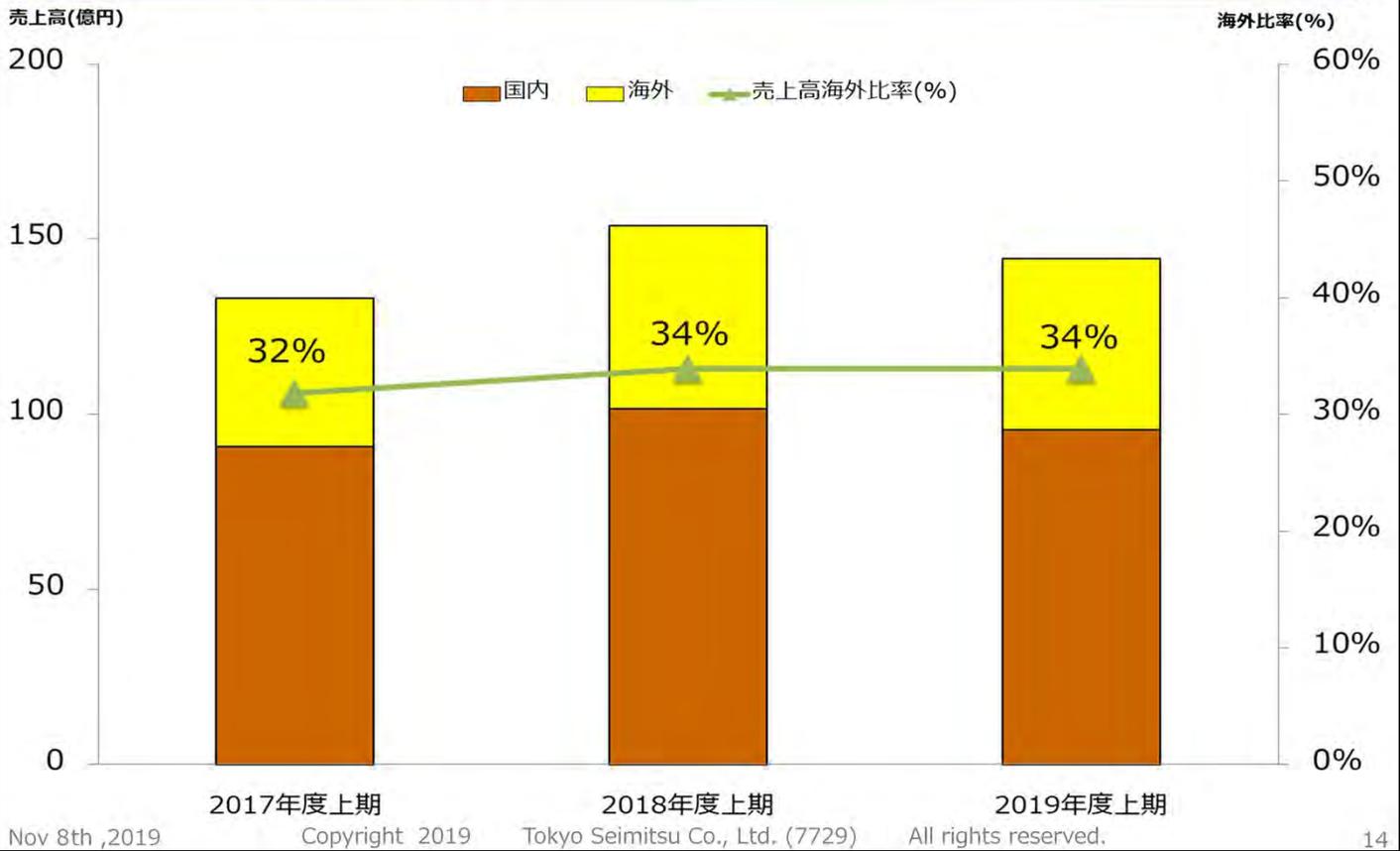
- ここ2,3年堅調だった受注は, 今年に入り減速傾向。期初想定下振れ
- 一方, 受注残高は高水準であり, 2019年度下期の売上に結び付けていく予定

計測 - 製品別動向



- 2019年度上期の製品別構成比は以下
なお当期より充放電試験システム事業(以下充放電)の売上高・受注高を含む
- 売上高(左側) : 汎用計測製品5割後半, 自動計測製品+充放電4割前半
- 受注高(右側) : 汎用計測製品6割前半, 自動計測製品+充放電3割後半

計測 - 地域別売上高



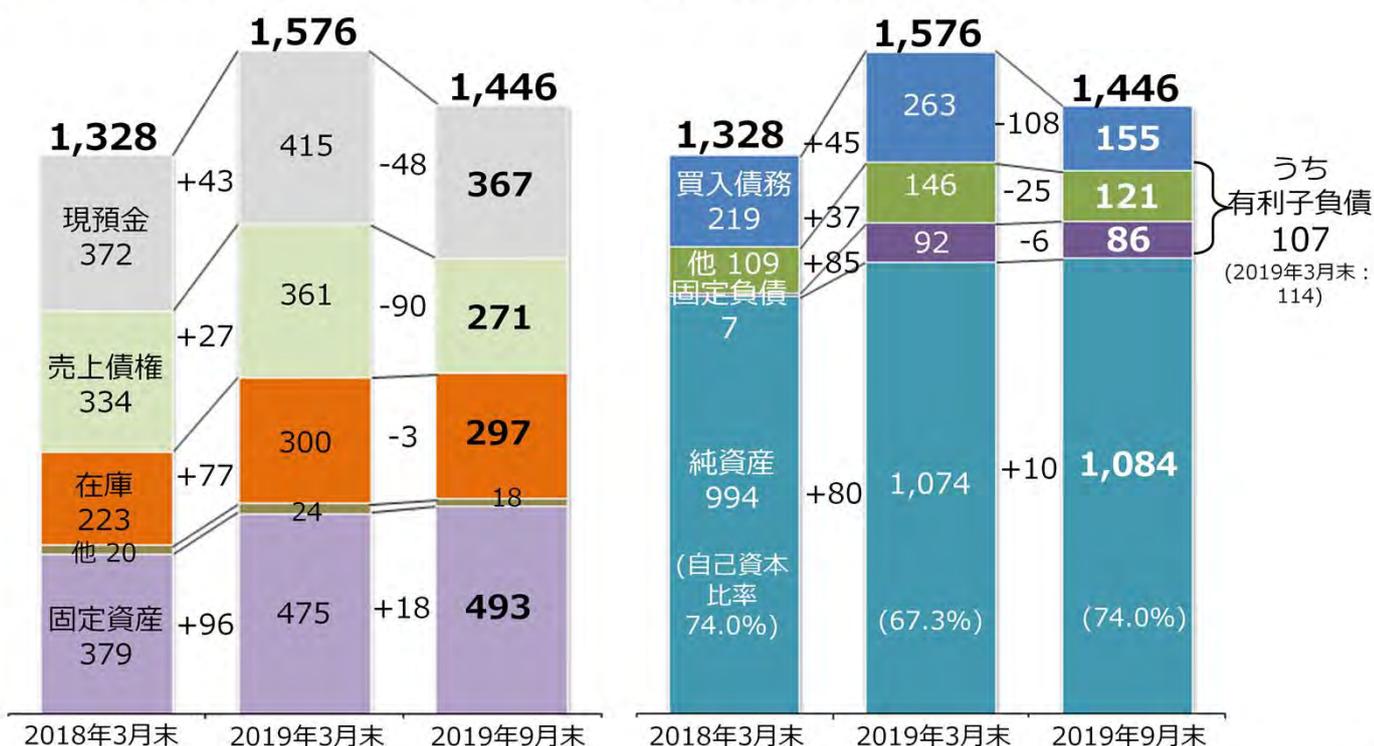
- 2019年度上期の海外売上高比率は34%で、前年並みを維持

貸借対照表



資産の部(億円)

負債・純資産の部(億円)

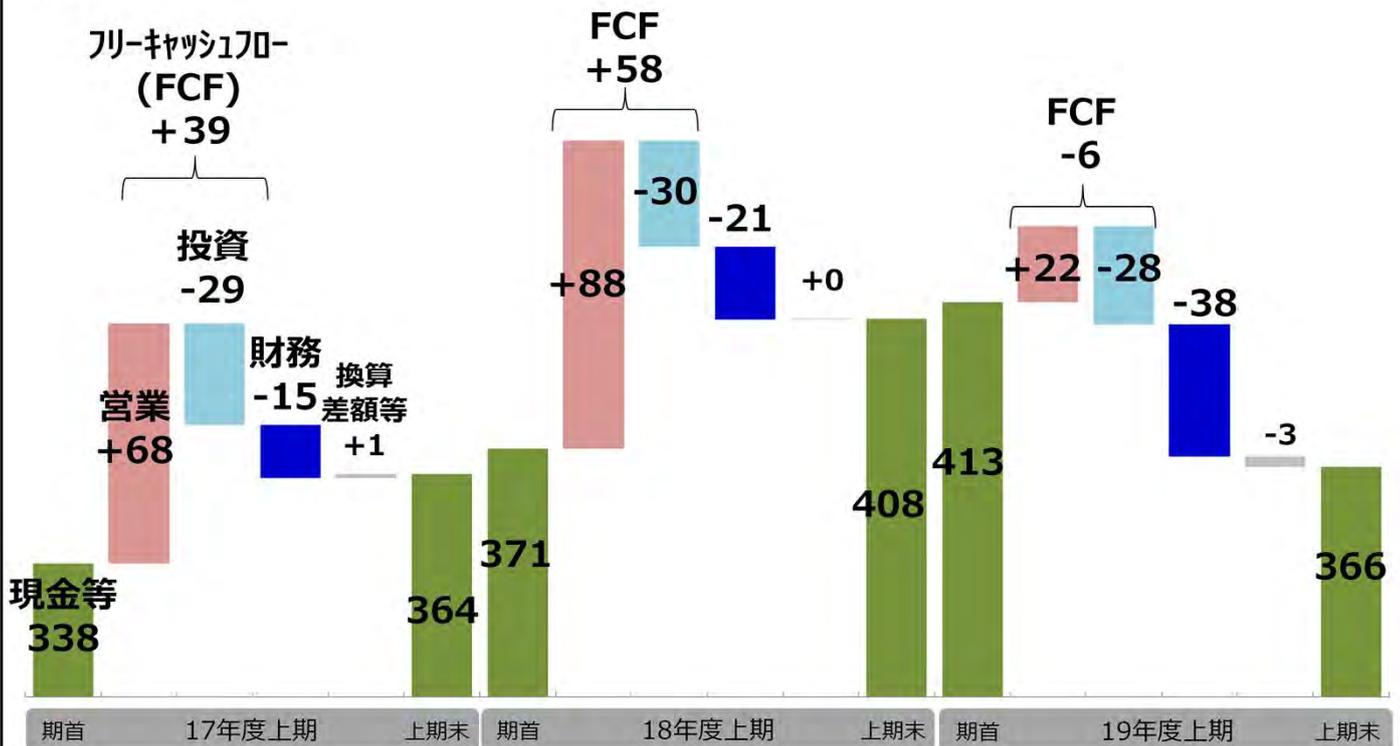


- 9月末の総資産は1,446億円(3月末比130億円減)
- 資産の部(左側) 増減の内訳は、現預金48億円、売上債権90億円、在庫3億円、他流動資産が6億円それぞれ減少の一方、固定資産が18億円増加
- 負債・純資産(右側) 増減の内訳は、買入債務108億円、その他流動負債25億円、固定負債6億円それぞれ減少の一方で純資産は10億円増加
- 9月末の自己資本比率は74.0%、有利子負債残高は107億円

キャッシュフロー(CF)



(億円)



Nov 8th ,2019

Copyright 2019

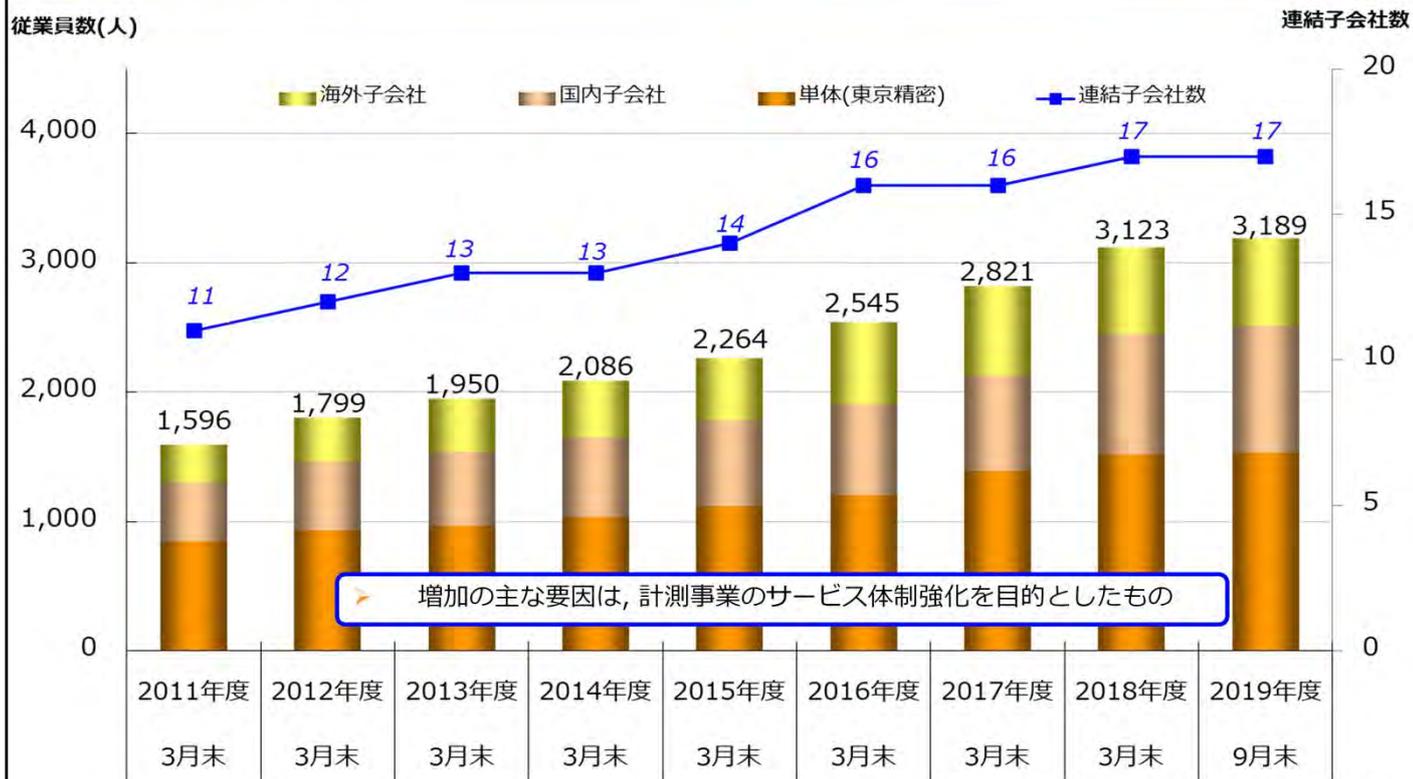
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

16

- 2019年度上期キャッシュフロー(以下CF)
 営業CFは22億円のプラス(利益計上並びに売上債権・買掛債務増減が主因)
 投資CFは28億円のマイナス(設備投資等が主因)
 この結果, 上期フリーCFはマイナス6億円
 財務CFは38億円のマイナス
- この結果, 2019年度上期末の現金等の残高は366億円となった

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算

- 9月末の連結従業員数(正社員+期末臨時従業員)は3,189名
- 3月末比 66名の増加
主因は計測サービス体制強化を目的とした増加

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円
(2020年度迄に)

両輪にて達成

売上拡大
(1,100億円を目指す)

利益率向上
(営業利益率20%以上を目指す)

- 当社は2018年5月に定量目標を開示
- 長期指標: ROE 10%以上維持
- 中期目標: 2020年度迄に営業利益220億円達成
- 売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す

**世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品
を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく**

理念を示すモットー:

「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

コーポレートブランド:

ACCRETECH

“Accrete (共生)” と “Technology(技術)” の合成語

- 中期目標, さらに将来の成長のベースにある
当社の企業理念や枠組みに変化はない
- 企業理念は, 「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して
世界No.1の商品を創り出し, 皆様と共に大きく成長してゆく」
- これを簡潔に表すモットー, 及びコーポレートブランド
「ACCRETECH (アクレーテク) 」を掲げ, 理念の実現に取り組んでいる

企業理念実現のための枠組み



当社事業構成の特徴

半導体

- 強み :
 - 精密位置決め制御技術
 - 内製化
- チャンス :
 - 新技術・新デバイス

計測

- 強み :
 - 高精度・高分解能測定技術
 - 信頼性
- チャンス :
 - 新分野・海外需要

- バランスの取れた事業構成
- 異なる事業領域を有することによる
安定性（需要変動影響を吸収）

○ 理念実現のための枠組み :

CSRやガバナンス, 強固な財務基盤をベースとして
成長投資を継続し, 業績拡大と企業価値の向上を実現する

○ 当社事業構成の持つ強み :

半導体事業の精密位置決め制御技術や内製化,
計測事業の高精度及び高分解能を実現する測定技術とその信頼性
需要の波が異なるセグメントを有する事業構成が全社業績安定に寄与

技術面

製品競争力強化, 対象市場拡大

生産面

生産能力拡充, 効率改善(自動化, 省人化)

利益率改善

情報共有化促進
サービス, 消耗品売上の拡充

中期目標達成



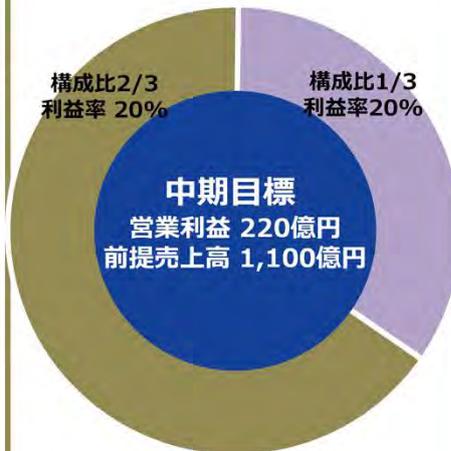
持続的な成長のために

積極的にESG活動を推進し, 企業価値向上を図る

- 2019年5月に発表した全社戦略は上記の通り
- 技術面: 既存製品の競争力を更に高め, 対象市場を更に拡大させる
- 生産面: 生産キャパシティの拡充と生産効率の改善を図る
- 利益率改善: 情報共有化の推進, 消耗品売上の拡充
- これらの目標達成を含めた持続的な成長のための基盤として ESG活動を積極的に推進したい

半導体製造装置

- 検査装置(プローバ)の“デパート化”戦略継続による 更なる市場拡大
- 加工装置のアプリケーションカ強化・連動したサービスビジネス並びに消耗品売上の拡大
- 内製化促進, 新工場運用



計測機器

- 電気計測 (充放電試験) 進出による対象市場拡大, シナジーの最大化
- 既存製品群の差異化・国内外顧客開拓と, 連動したサービスビジネスの拡大
- 生産効率化・自動化



Nov 8th ,2019

Copyright 2019

Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

22

- 中期目標の前提となる売上高・利益構成並びに利益率は中央の円グラフの通り
- 半導体では, 今後加速化が予想される市場の拡大を控え, 製品やアプリケーション/サービスの対応力と, キャパシティを十分に備えることに注力
- 計測では, 自動車EV化の動きを前にして, 電気計測分野へ進出
これにより, 当社の事業領域の拡大とシナジーの最大化を目指す
生産面では, 生産の効率化・自動化を進める狙いで新棟の建設を進める

キャパシティ拡充(半導体：日野工場, 美山工場)

- 用地・建物取得によりキャパ拡充
- 賃貸工場(美山)も活用中



キャパシティ拡充(計測：土浦MI棟)

- 新棟(MI棟)着工 
- 2020年度稼働予定
- 各種効率化・改善策を適用予定

MI: *Monozukuri* Innovation

効率化

- ERP 安定稼働
- 業務改善・効率化

アプリ対応強化 (台湾新アプリセンター設立)

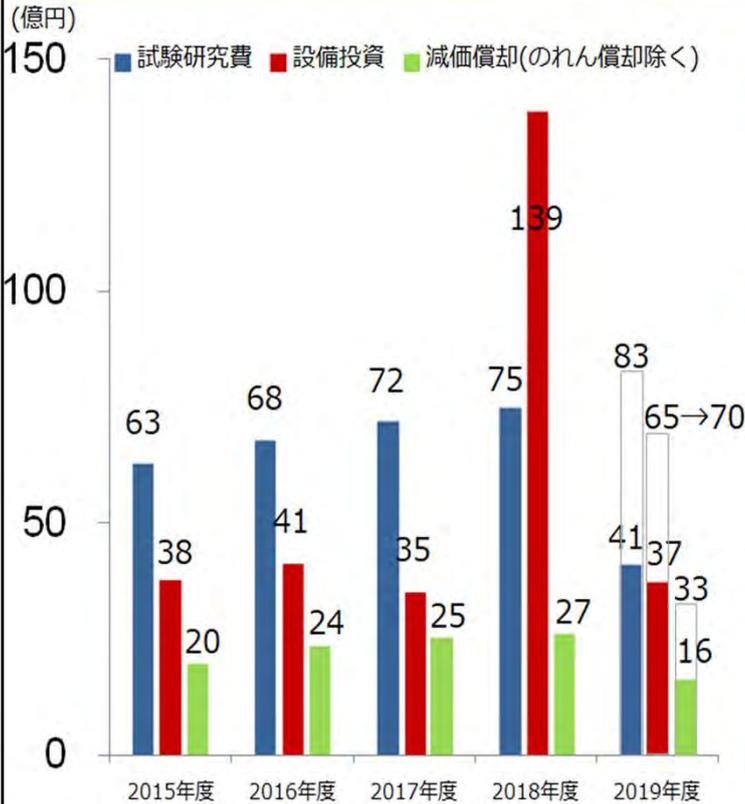
- 予定通り進捗中
- 2020年度稼働予定

アプリ対応強化 (大阪アプリセンターリニューアル)

- 予定通り進捗中
- 2019年度稼働予定

- キャパシティ拡充(上段)は, 半導体・計測双方で計画進行中
半導体：東京都日野市の工場用地・建物を取得, 美山工場も活用中
計測：茨城県土浦市 土浦工場敷地内 新棟建設中
- 効率化(下段左)は, 4月以降稼働しているERPに加え,
業務・周辺システムの改善を通じた効率化の取り組みを進めている
- アプリケーション対応強化(下段中央, 右) は, 計画通り進行中

試験研究費, 設備投資, 減価償却



研究開発：製品力強化・競争力維持

- 売上高対比10%内を目安に強化

設備投資：能力増強・効率化等

- 中期目標の期間内で200億円超を計画 (新工場, 自動化, アプリ等)
- 2019年度は 計測新工場, アプリ投資中心
- 半導体 新棟(日野)建設 21-22年度計画

減価償却

- 2019年度はERP稼働により前年比増加
- 2020年以降は軽微な増加を見込む

- 試験研究費：売上高対比10%を目安に強化,
2019年度上期実績41億円, 通期計画83億円
- 設備投資：メンテナンス投資等を除き, 中期目標期間内で200億円超を計画
2019年度は計測新工場やアプリケーションセンタ投資が主体
2019年度上期実績37億円, 通期計画70億円(期初計画65億円)
- 減価償却：2019年はERP稼働により特に増加, 翌年度以降は軽微な増加を想定
2019年度上期実績16億円, 通期計画33億円

Environment(環境)

- 環境配慮型製品の開発, 温暖化防止, 資源削減: 取り組みを継続

Social (社会)

- 働き方改革: 女性活躍推進に注力(職域拡充, 柔軟なライフイベント対応)

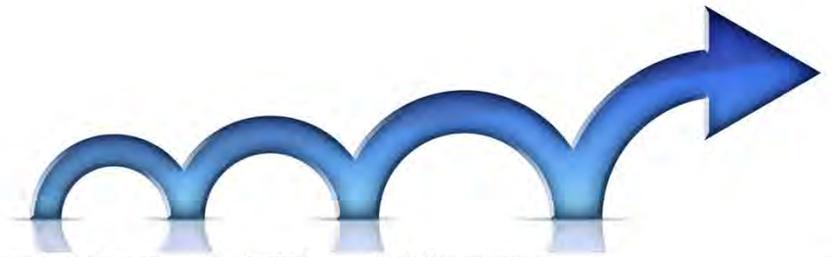
Governance(ガバナンス)

- コンプライアンス: 遵守体制・情報セキュリティ体制の強化
- リスクマネジメント: 事業継続計画(BCP) の強化



- ESGについて行う取り組みと2019年度上期実績は記載の通り
- 上期は女性活躍やBCPに注力
今後はさらに全社で積極的な取り組みを行いたい

- 2019年度の事業環境は 当初前提より変化
 - 半導体：大きな成長過程の踊り場
 - 計測：当初想定より軟調
- 両事業とも中長期の成長が期待できる
2019年度は「準備の年」との位置づけに変更なし
- 財務健全性を維持しつつ, 成長・開発投資は継続



- 足許の市場環境は, 中期目標策定時から大きく変化
2020年度の市場が想定環境に戻るかについては不透明感があるが,
両事業とも一定の回復が期待できる
- 加えて長期的には底堅い需要が見込まれることから,
今年度は「準備の年」との位置づけを変更しない

半導体

- ロジック向け中心に 設備需要回復の兆しあるも、本格回復のタイミングは更なる注視が必要
- 来たる市場拡大に備え、必要な研究開発・設備投資を継続

計測

- 国内外の自動車向け製品需要は軟調
- ものづくり全体の回復に伴う計測需要の回復は2020年度以降を見込む

○ 2019年度の業績予想の前提

○ 半導体：

ロジック半導体の前工程の動きに連動した後工程回復の兆しが見られる
ただ、本格的な受注回復の時期を見定めるには注視が必要
必要な準備(開発・設備投資等)を粛々と進める

○ 計測：

工作機械受注の軟調さが示すように、国内外の自動車向け製品の需要が弱い
半導体関連産業の回復に連動したモノづくり市場全体の回復に伴う
計測需要の回復は2020年度以降になると予想

2019年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2018年度			2019年度				
	上期	下期	通期	上期	下期予	通期予	8月予想比	前期比
売上高	512	503	1,015	420	440	860	-20	-15%
営業利益 (営業利益率)	102 (20%)	100 (20%)	202 (20%)	56 (13%)	64 (15%)	120 (14%)	-5	-41%
経常利益	108	100	208	57	64	121	-4	-42%
当期純利益	79	68	147	43	47	90	±0	-39%
1株配当	125円(普通配105円, 記念配20円)				76円		±0	-49円

セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	397	256	653	229				
	売上高	358	333	691	276	274	550	±0	-20%
(計測)	受注高	175	161	336	154				
	売上高	154	170	324	144	166	310	-20	-4%

- 2019年8月9日発表の通期予想を修正
- 半導体製造装置部門は変更なし, 計測は足許状況を踏まえ修正
- 当期純利益および通期配当予想の修正はなし

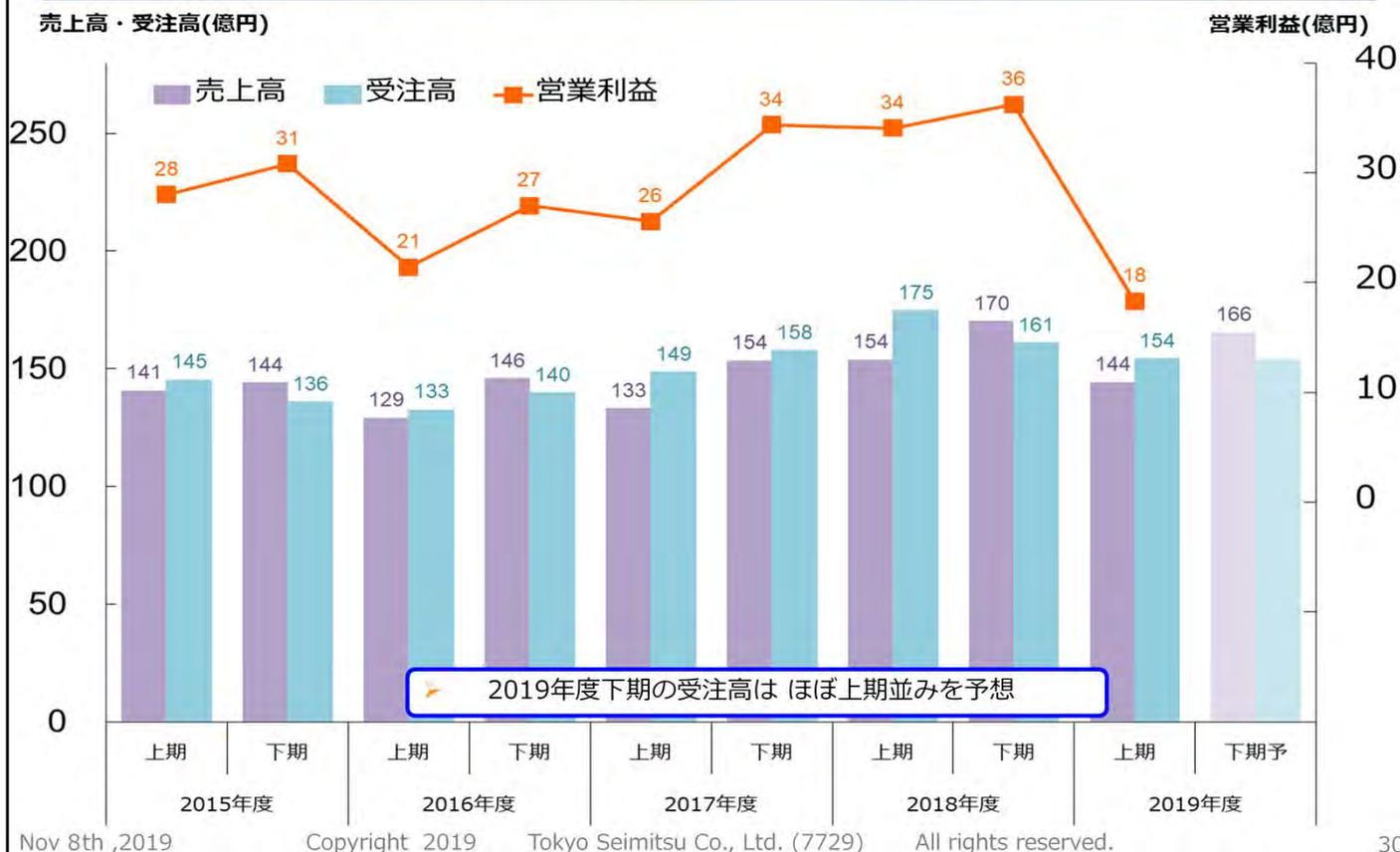
- 上期の進捗と足許の状況を踏まえ, 2019年度業績予想を修正
- 売上高860億円, 営業利益120億円, 経常利益121億円へ修正
純利益90億円および1株配当予想76円は据え置き
- セグメント別売上予想
半導体: 通期550億円(据え置き), 計測: 通期310億円

半導体 - 売上・受注高 見込



- 2019年度下期の半導体受注高は上期比微増を想定
- 2019年度下期の製品構成比の想定
 売上高：検査装置6割半ば, 加工装置3割半ば
 受注高：検査装置6割, 加工装置4割

計測 - 売上・受注高 見込



- 2019年度下期の計測受注高はほぼ上期並みを想定
- 2019年度下期の製品構成比の想定は、売上高・受注高共に、
汎用計測製品6割、自動計測製品並びに充放電試験システム合算で4割



<http://www.accretech.jp/>
<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>

